



电力半导体三相整流模块说明书

一、特性

- 1、芯片采用沟槽氮化硅玻璃烧结工艺。
- 2、通态压降低，功耗小。
- 3、高温 175℃ 下反向漏电流小。
- 4、浪涌电流能力强。
- 5、塑料灌封结构，安装方便，可靠性高。
- 6、热性能好。

二、质量等级

- 1、企军标 JP 参照 GJB33A-97 执行
- 2、普军 J: 参考 QZJ840611A 执行。

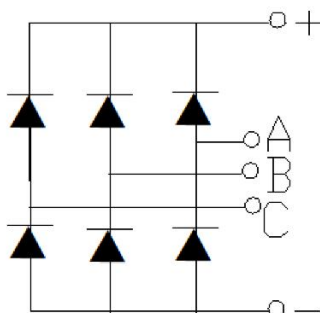
三、三相整流管模块额定值和特性参数



表1：三相整流管模块额定值和特性参数

电参数 产品型号	$I_{F(AV)}$	V_{RRM}	I_{RRM}	V_{FM}	T_{jM}	R_{jc}	V_{ISO}	产品外形图	备注
	A	V	mA	V	℃	℃/W	V_{AC}		
MDS	50	200~2500	≤5	≤1.2	175	0.54		图 6-8	产品详细电特性、外形图以各产品的技术规格书为准。
	75	200~2500	≤5	≤1.2	175	0.30	2500	图 6-8	
	90	200~2500	≤5	≤1.2	175	0.21	2500	图 6-9	
	100	200~2500	≤5	≤1.2	175	0.21	2500	图 6-9	
	130	200~2500	≤5	≤1.2	175	0.20	2500	图 6-10	
	150	200~2500	≤5	≤1.2	175	0.20	2500	图 6-10	
	200	200~2500	≤6	≤1.3	175	0.20	2500	图 6-11	

四、电力半导体三相整流模块电连接方式：



五、产品安装注意事项，详见本手册第 116 页。



附件 6：M 系列电力半导体整流模块类产品外形图

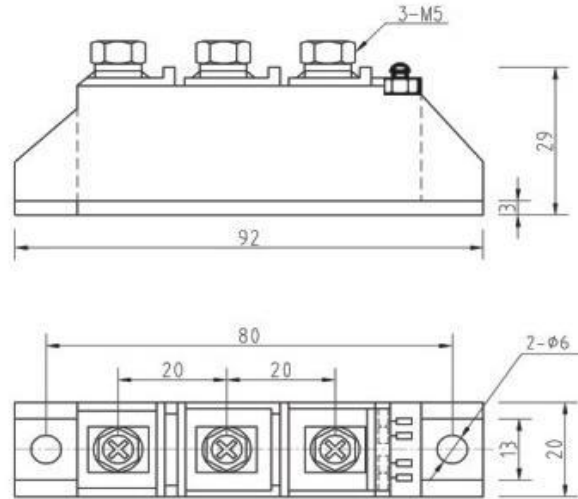


图 6-1：桥臂模块外形图 1

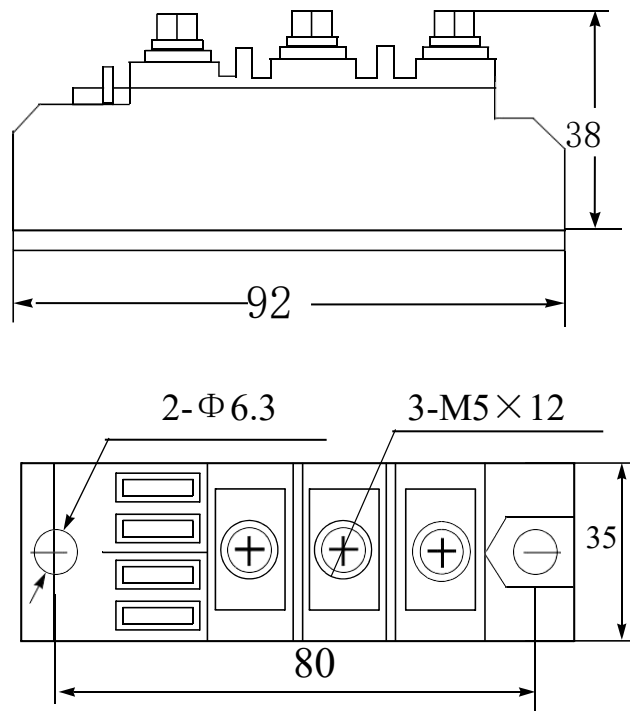


图 6-2：桥臂模块外形图 2

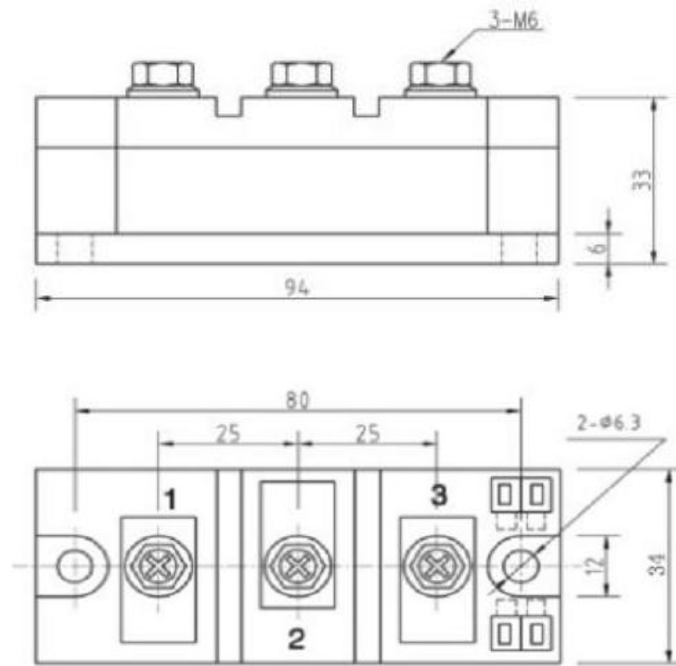


图 6-3 : 桥臂模块外形图 3

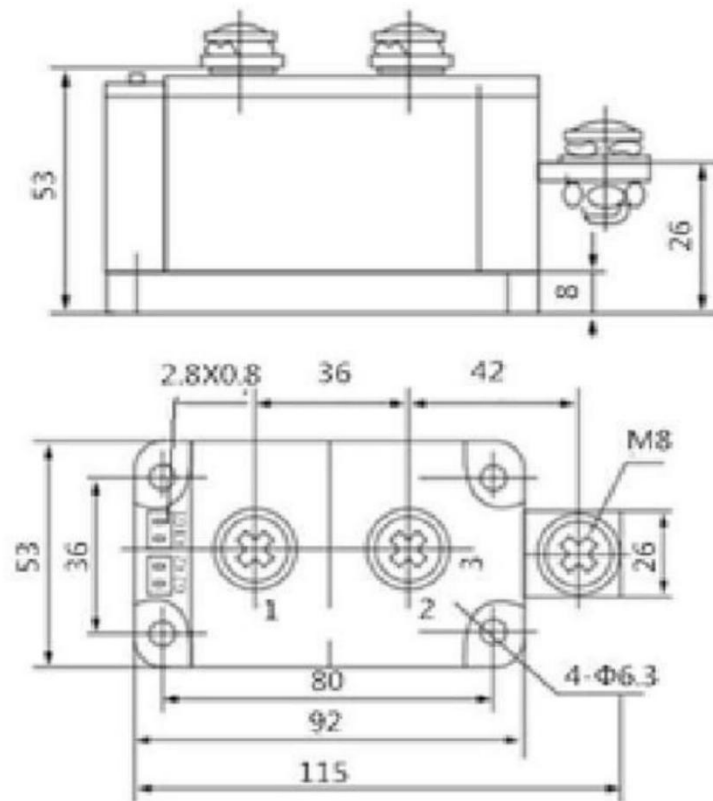


图 6-4 : 300A 桥臂模块外形图 4

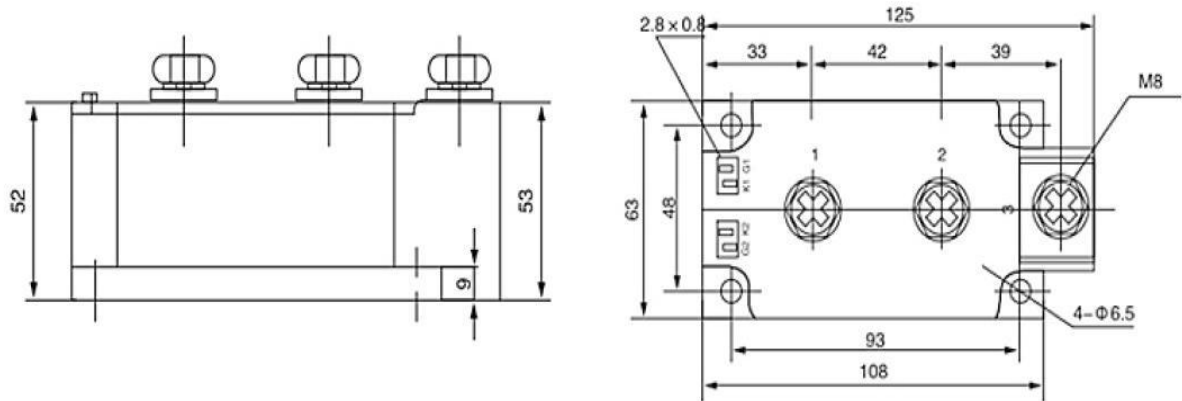


图 6-5 : 400A/500A 桥臂模块外形图 5

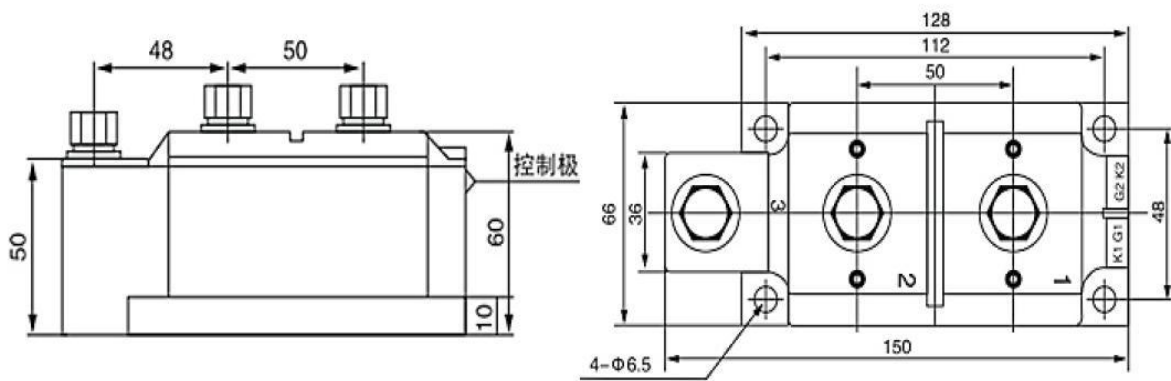


图 6-6 : 800A 桥臂模块外形图 6

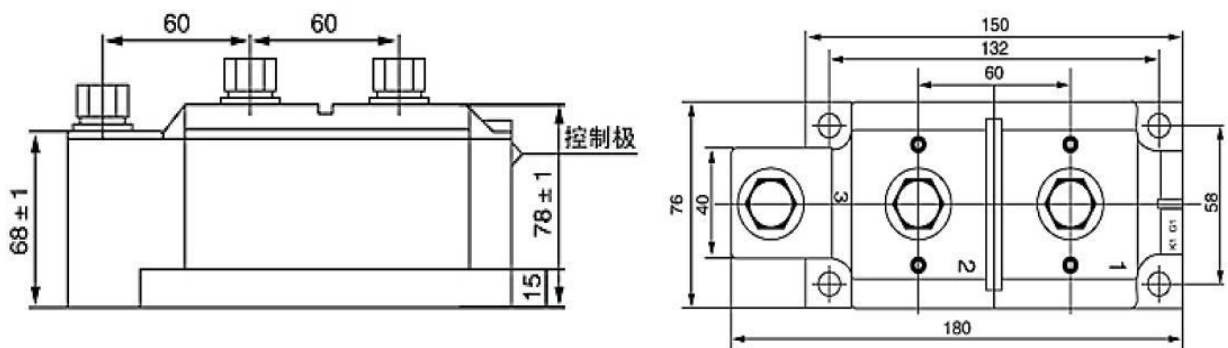


图 6-7 : 1000A 桥臂模块外形图 7

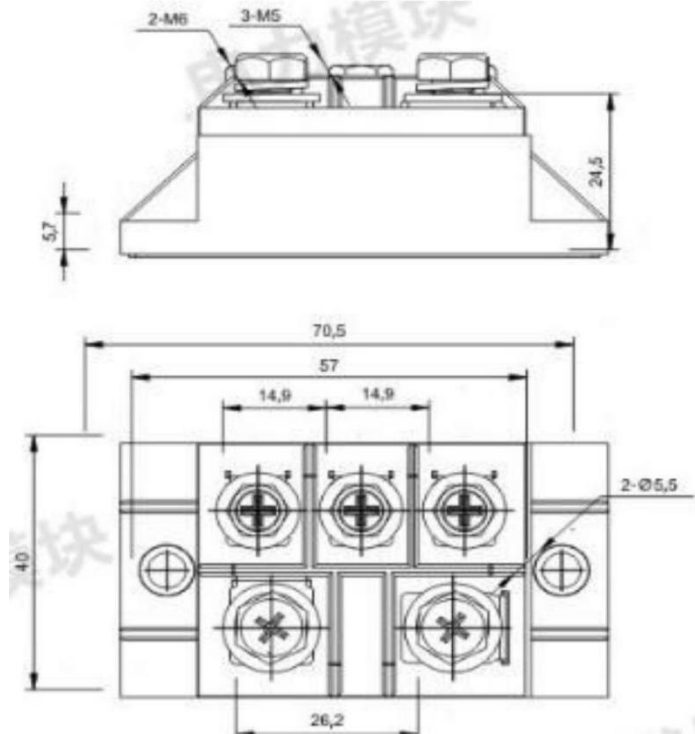


图 6-8 : 三相模块外形图 1

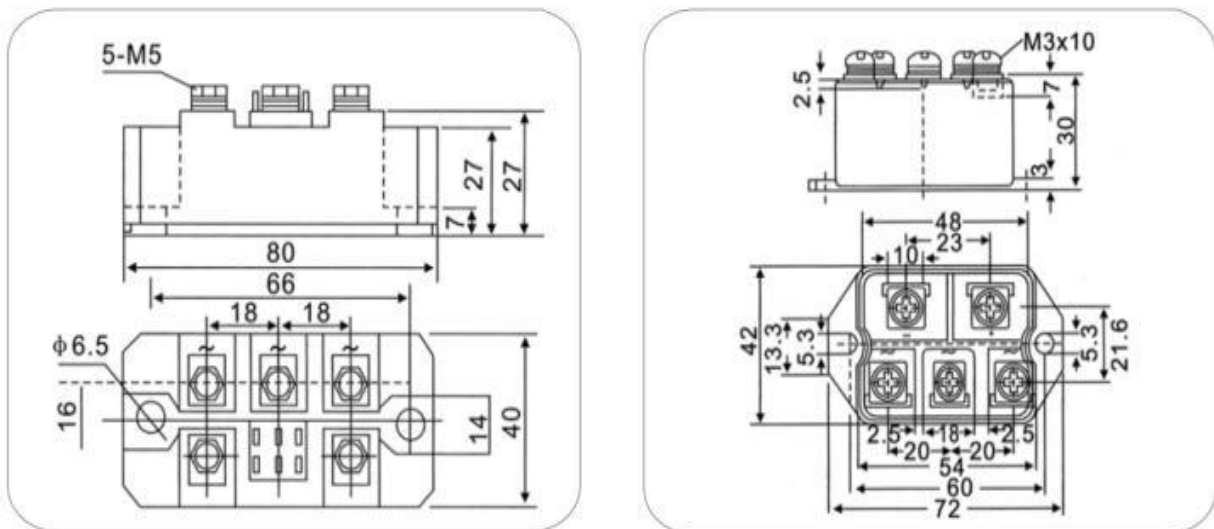


图 6-9 : 三相模块外形图 2

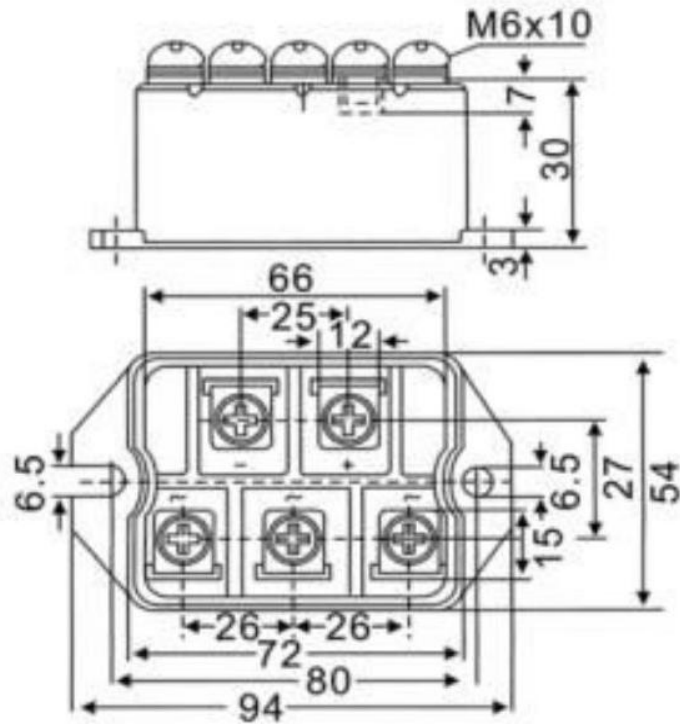


图 6-10 : 三相模块外形图 3

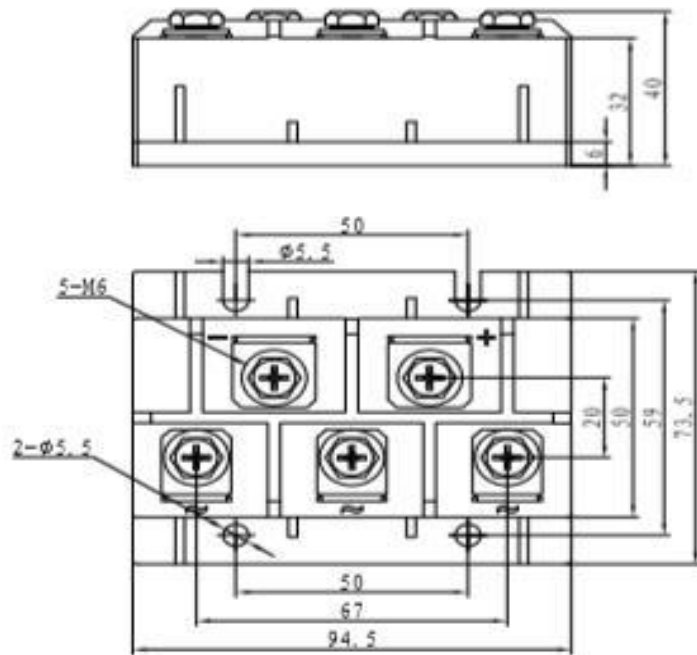


图 6-11 : 三相模块外形图 4